智慧醫療器材品質管理與風險分析研討會

智慧醫療近年發展迅速，國內資通訊（ICT）產業紛紛投入智慧醫材領域。為協助相關業者了解智慧醫材品質系統建置與風險管理實務經驗，衛生福利部食品藥物管理署委託財團法人工業技術研究院量測技術發展中心舉辦『**智慧醫療器材品質管理與風險分析研討會**』，敬邀國內外相關業者踴躍出席。

講師簡介：

工研院生醫所 智能組織修復技術部 張方杰 副研究員

炳碩生醫 品質管理處 高良瑋 處長

日期：110 年 10 月 18 日（星期一）下午

時間	議題	主講人
13:00~13:35	報到	
13:35~13:40	食品藥物管理署長官致詞	
13:40~14:30	脊椎滑脫病變篩檢智慧軟體品質系統建置與風險分析經驗分享	張方杰 副研究員
14:30~14:40	休息	
14:40~15:40	品質管理系統 ISO TIR 80002-1 介紹	高良瑋 處長
15:40~16:00	Q & A 與 綜合討論	

主辦單位：衛生福利部食品藥物管理署

承辦單位：財團法人工業技術研究院量測技術發展中心

費用：免費

報名網址：https://wlsms.itri.org.tw/ClientSignUp/Index.aspx?ActGUID=5858BD4C40

報名截止日期: 110 年 10 月 14 日（星期四）

辦理方式: 活動前兩天發送線上會議室連結與密碼：

聯絡人：陳小姐（TEL: 03-573-2279；e-mail: itri533513@itri.org.tw）

＊ 本說明會僅接受網路報名，每場名額有限，承辦單位保留受理報名之權利。

＊ 主辦單位保留變更議程、講題及主講人之權利。若有任何未盡事宜，主辦單位亦保有隨時補充、說明、修改之權利。

＊ 報名成功者，承辦單位將於活動前 2 日，以 e-mail 方式寄發「報到通知」。如未收到，請主動來電洽詢。